

Pressemitteilung

#ew25: Halle 3, Stand 255

POLYRACK TECH-GROUP realisiert individuelle Anforderungen an Gehäuse- und Systemlösungen

Straubenhardt, 21. Januar 2025 – Vom 11. bis 13. März 2025 präsentiert die POLYRACK TECH-GROUP in Halle 3, Stand 255 verschiedene Produktlösungen an Gehäusen, Einzelkomponenten und Systemen. Die Produkte zeigen den Besuchern der embedded world 2025 exemplarisch, wie Unternehmen von der Beratungs- und Umsetzungskompetenz POLYRACKs als Partner und Spezialist für komplexe Verfahren und State of the Art-Technologien profitieren.

Zum umfangreichen Dienstleistungsportfolio gehören zum Beispiel:

- Entwicklungsbegleitende Vorbereitung für CE- und UL-Zulassung für elektromechanische Baugruppen und Systemlösungen
- Vorgelagerte Entwicklung, wie z.B. die simulationsgestützte Bauteilbetrachtung via Füll- und Verzugsanalyse sowie Wärmesimulationen im Systembereich
- Verarbeitung aller Arten von thermoplastisch verarbeitbaren Kunststoffen mit und ohne Füllstoffe / Verstärkung – von Standard (PP, PMMA, ABS, PS, ...) über technische (PC, PA, POM, PBT, ...) bis hin zu Hochleistungskunststoffen (PVDF, PPS, PEEK, LCP, ...)

Vor Ort stehen zudem die folgenden Produktreihen für ein erstes Hands-On zur Verfügung:

FrameTEC: Das elegante industrielle Tischgehäuse für 19“-Einschübe mit hoher Flexibilität bei Gestaltung und Maßen vereint ästhetische Formgebung und Konstruktion in einem sich selbsterklärenden Design. Die große Anzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und wechselbaren Komponenten macht das



FrameTEC



Kundenspezifische Systemapplikation



IPC02

Gehäuse zum idealen Träger in Anwendungsbereichen mit hohem Qualitätsanspruch.

Kundenspezifische Systemapplikation: Designgehäuse mit integriertem Display und Touchscreen für den Einsatz als Tischgerät.

IndustriePC: Die System-Plattform IPC02 ist komplett aus Edelstahl gefertigt und verfügt über beste mechanische sowie EMV-Eigenschaften. Bei einer standardmäßigen Höhe von 4HE bietet sie Einbaumöglichkeiten für ATX-Formfaktor-Mainboards, wahlweise können auch Mainboards für Slot-CPU-Karten verwendet werden. Hinter einer abschließbaren Frontklappe sind die Bedienelemente (u.a. Power- und Reset-Taster sowie zwei USB 3.0-Anschlüsse) und die wechselbare Staubfiltermatte angeordnet. Die Systeme sind ab Werk mit zwei hochwertigen Gehäuselüftern zur Kühlung ausgestattet.

###

Über die POLYRACK TECH-GROUP (www.polyrack.com)

Die POLYRACK TECH-GROUP entwickelt und produziert hochqualitative Systemlösungen für die Elektronik. Dank breitem Technologiespektrum in der mechanischen Fertigung, Systemtechnik/ Elektronik, Kunststofftechnik und Oberflächenbearbeitung bietet POLYRACK Electronic Packaging für jeden Bedarf. Das Leistungsangebot reicht von der Beratung in der Konzeptionsphase über die Entwicklung, Produktion und Assemblierung bis hin zu Logistiklösungen und Sourcing Services.

Die Unternehmensgruppe umfasst die POLYRACK Electronic-Aufbausysteme GmbH, RAPP Kunststofftechnik GmbH, POLYRACK Aerospace GmbH, Metalle in Form Geräteteile GmbH sowie Tochterunternehmen in Amerika, Belgien, China, Großbritannien und der Schweiz. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt weltweit über 500 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen summierten Umsatz von 98 Millionen Euro in der Gruppe.

Pressekontakt:
POLYRACK TECH-GROUP, Maximilian Schober,
Tel: +49 7082 7919-771, maximilian.schober@polyrack.com

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations, www.lorenzoni.de
Melanie Nagy, Tel: +49 8122 55917-16, melanie@lorenzoni.de